

パワーデバイス用無電解ニッケル/金, 無電解ニッケル/パラジウム/金めっきプロセス
Electroless Ni/Au, Ni/Pd/Au Plating Process for Power Device

トップUBPプロセス

TOP UBP PROCESS

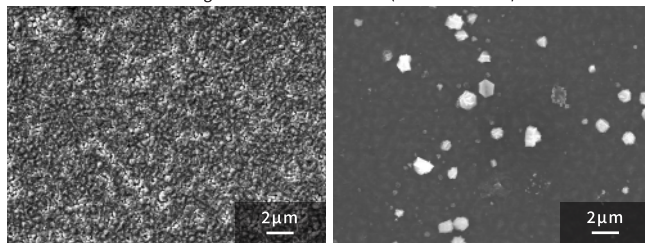
- アルミニウムおよびアルミニウム合金スパッタ膜へのめっきプロセス
Plating process for aluminum- and aluminum-alloy sputtering layer
- 前処理によるエッチングが均一で、局部的腐食(スパイク)が少ない
Improve uniformity in etching process, can prevent local corrosion and Ni spike
- ジンケートが緻密に析出するため、めっき平滑性に優れる
Make zincate film finely, increase smoothness of deposit

処理工程 Process

	アルミニウム電極用 For Al electrode	アルミニウム合金電極用 For Al-alloy electrode
脱脂 Cleaning	トップUBPクリーンW TOP UBP CLEAN W	
エッチング Etching	トップUBPエッチングWT TOP UBP ETCHING WT	トップUBPエッチングW TOP UBP ETCHING W
デスマット Desmutting	トップUBP-DSW TOP UBP-DSW	
1 st ジンケート 1 st zincate	トップUBP-AZW TOP UBP-AZW	
ジンケート剥離 Stripping	硝酸 Nitric acid	
2 nd ジンケート 2 nd zincate	トップUBP-AZW TOP UBP-AZW	トップUBP-ZNW TOP UBP-ZNW
無電解ニッケルめっき Electroless nickel plating	トップUBPニコロンHR TOP UBP NICORON HR	
(無電解パラジウムめっき) (Electroless palladium plating)	(トップUBP-PDL) (TOP UBP-PDL)	
無電解金めっき Electroless gold plating	トップUBPゴールドSR TOP UBP GOLD SR	

緻密なめっき皮膜 Fine and uniform plating film

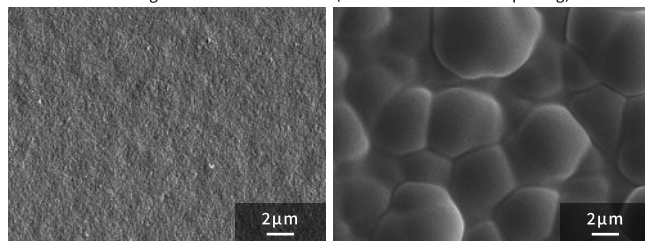
2ndジンケート後の表面SEM外観(アルミニウム電極上)
SEM image of Al electrode surface(after 2nd zincate)



トップUBPプロセス (アルミニウム電極用)
TOP UBP PROCESS (For Al electrode)

従来プロセス
Conventional process

無電解ニッケルめっき後の表面SEM外観(アルミニウム電極上)
SEM image of Al electrode surface(after electroless nickel plating)



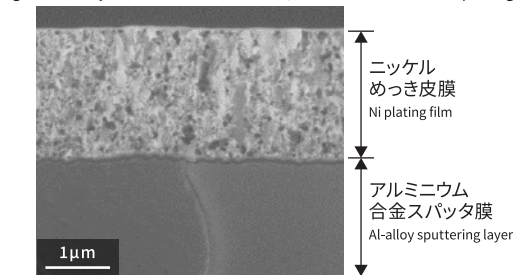
トップUBPプロセス (アルミニウム電極用)
TOP UBP PROCESS (For Al electrode)

従来プロセス
Conventional process

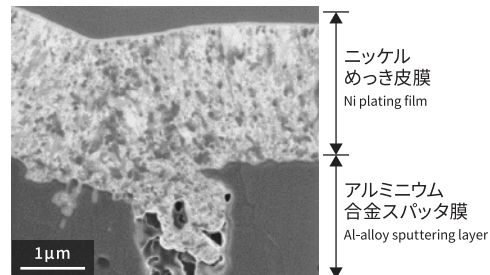
局部腐食の少ない前処理

Prevent local corrosion by improving pre-treatment

無電解ニッケルめっき後の断面(アルミニウム合金電極上)
SEM image of Al-alloy electrode cross section(after electroless nickel plating)



トップUBPプロセス (アルミニウム合金電極用)
TOP UBP PROCESS (For Al-alloy electrode)



従来プロセス
Conventional process